

プラナリゼーション CMP とその応用(1)

3月13日 10:40~12:00 J室

J06・J07 (キーノートスピーチ)

シリコンパワーチップの構造と製造プロセス

○山本秀和 (千葉工大)

J08

SiO₂-CMP における材料除去メカニズムに関する研究—凝着現象に関する定量的評価—

○高野祐一・鈴木恵友・カチョーンルンルアンパナート・木村景一 (九工大)

J09

紫外光支援加工による大口径 SiC ウェハ研磨に関する研究

○坂本武司・稲木 匠・小田和明・峠 睦 (熊本大)

プラナリゼーション CMP とその応用(2)

3月13日 13:00~14:20 J室

J13

MEMS 技術を応用した CMP 用マイクロパターンパッドの研究—Ni めっき金型を用いたマイクロパターンパッドの製作—

○磯野慎太郎・鈴木恵友・伊藤高廣・カチョーンルンルアンパナート・占部正和・木村景一 (九工大) ・田代康典・鬼木喬玄 (三島光産)

J14

光学的フーリエ変換に基づく CMP 用ポリシングパッドの表面形状評価に関する研究(第四報)—レーザ光入射角の選定—

○榎田高志・木村景一・カチョーンルンルアンパナート・鈴木恵友・田尻貴寛 (九工大)

J15

CMP の研磨レートに及ぼすパッド表面性状評価パラメータの影響分析

畝田道雄・○前田有樹 (金沢工大) ・澁谷和孝・中村由夫・市川大造 (不二越機械工業) ・石川憲一 (金沢工大)

J16

スラリー循環型工具を用いた高能率 CMP (第2報) —新型溝パターンによる循環能力の向上—

○平井洋介・吉富健一郎・餅田正秋 (防衛大)

プラナリゼーション CMP とその応用(3)

3月13日 14:40~16:00 J室

J18

研磨パッドの長寿命化を指向した再生用補助板と周辺技術開発（第1報）—再生原理とその特長—

○鈴木大介・鈴木辰俊・鈴木英資（東邦エンジニアリング）

J19

サファイアのメカニカルポリシングにおけるスラリーフローの定量評価—スラリーフローに及ぼす定盤表面性状の影響—

畝田道雄・○福田有哉（金沢工大）・伊藤康昭・堀田和利・杉山博保・森永 均（フジミンコーポレーテッド）・石川憲一（金沢工大）

J20

サファイア CMP における研磨条件が研磨レートとスラリーフローに及ぼす影響

畝田道雄・○表 辰憲・福田有哉（金沢工大）・伊藤康昭・堀田和利・玉井一誠・森永 均（フジミンコーポレーテッド）・石川憲一（金沢工大）

J21

水酸化フラーレンを利用したサファイア CMP 高効率研磨手法に関する研究

○河北誠也・山城天心・木村景一・カチョーンルンルアンパナート・鈴木恵友（九工大）

プラナリゼーション CMP とその応用(4)

3月13日 16:20~17:20 J室

J23

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発 第1報—マルチ産学連携共同研究プロジェクト設立の概要—

○土肥俊郎・山崎 努・瀬下 清・市川大造（九州大）

J24

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発 第2報—SiC 基板の高効率・高精度ポリシングの検討—

○山崎 努・土肥俊郎・瀬下 清・大坪正徳・塚本敬一・紀 文勇・若林豊博（九州大）・住澤春男（不二越機械工業）

J25

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発 第3報—高プレストン係数のパッド試作とガラス基板の加工特性—

○瀬下 清・土肥俊郎・山崎 努・Lien Thi Ngoc Le・大坪正徳・遠藤 浩・松永洋子・張 吉（九州大）

プラナリゼーション CMP とその応用(5)

3月14日 9:00~10:20 J室

J31・J32 （キーノートスピーチ）

ダイヤモンドパワーデバイス・ウェハの研究状況と CMP への期待

○鹿田真一・山田英明・坪内信輝・空野由明・茶谷原昭義・梅澤 仁・加藤有香子（産総研）

J33

先端的難加工基板の高効率精密加工法の研究（第1報）—新しい加工法と加工プロセスのコンセプトの提案—

○土肥俊郎（九州大） ・ 佐野泰久（大阪大） ・ 黒河周平・曾田英雄（九州大） ・ 大西 修（宮崎大） ・ 畝田道雄（金沢工大）

J34

先端的難加工基板の高効率精密加工法の研究（第2報）—疑似ラジカル場を想定した加工変質層の形成によるPCVM加工速度の増大—

○佐野泰久（大阪大） ・ 土肥俊郎・黒河周平（九州大） ・ 曾田英雄（並木精密宝石） ・ 大西 修（宮崎大） ・ 畝田道雄（金沢工大） ・ 岡田 悠・西川央明・山内和人（大阪大）

プラナリゼーションCMPとその応用(6)

3月14日 10:40~12:00 J室

J36

CMPにおける研磨装置の挙動解析に関する基礎検討

畝田道雄・○高橋佳宏・前田有樹（金沢工大） ・ 澁谷和孝・中村由夫・市川大造（不二越機械工業） ・ 石川憲一（金沢工大）

J37

エアバッグ方式の研磨ヘッド構造を考慮したCMPプロセスのEHL解析

○浅羽正和・鈴木教和・社本英二（名古屋大） ・ 安田穂積・山木 暁（荏原製作所）

J38

研磨による無反りウエハの創成（第3報）—冷凍ピンチャックの冷却特性と研磨への適用—

○吉富健一郎・竹鼻亮道・宇根篤暢・餅田正秋（防衛大）

J39

Study on Variable Rotation Polishing in CMP Process (1st report)—Investigation of the Variable Rotation Polishing Efficiency—

○Phaisalpanumas Pipat・Keiichi Kimura・Keisuke Suzuki・Khajornrungruang Panart（九工大）

プラナリゼーションCMPとその応用(7)

3月14日 13:00~14:20 J室

J43

ナノ複合砥粒の微細構造がガラス研磨特性に与える影響

○本間隆行・川原浩一（ファインセラミックスセンター） ・ 須田聖一（静岡大）

J44

ガラス研磨用パッドの物性と研磨特性

○富樫英世・丸山高宏・澤野 勉（三重県産業支援セ）

J45

ガラス研磨における化学的作用の定量的評価

○澤野 勉・丸山高宏・森脇 悠（三重県産業支援セ）

J46

ガラス基板の研磨における酸化マンガン系スラリーの開発と研磨メカニズムの考察

○武藤美代・瀬下 清・黒河周平・土肥俊郎・梅崎洋二・山崎 努（九州大）